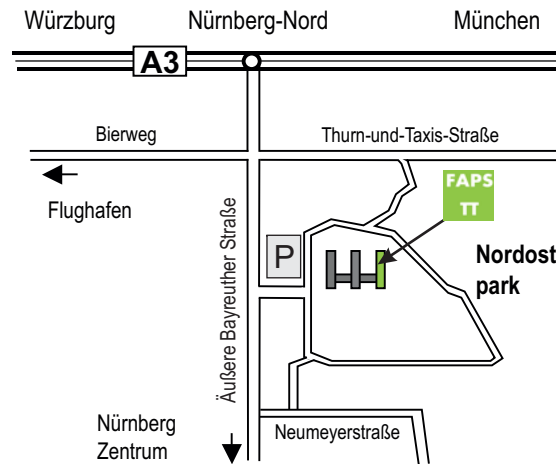


Bitte senden Sie uns die ausgefüllte
Anmeldung per Post, Fax oder E-Mail

- im Umschlag an die vorgedruckte Adresse
- per E-Mail an service@faps-tt.de
- per Fax an 0911 / 58058-77



Veranstaltungsort:

Das Seminar findet im „Forum im Park“ der
Forschungsfabrik Nürnberg, Nordostpark 89, statt.

Anmeldung:

Die Teilnahme erfolgt nach vorheriger Anmeldung mit
Vorlage der Anmeldebestätigung. Verwenden Sie bitte
zur Anmeldung die vorgedruckte Antwortkarte. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Registrierung erfolgt
nach Eingangsdatum.

Teilnahmegebühr und Leistungen:

Die Teilnahmegebühr in Höhe von 340,- € zzgl. MwSt. ist
nach Rechnungsstellung auf das dort angegebene
Konto zu überweisen und schließt Tagungsunterlagen,
Pausengetränke und Mittagessen mit ein.

Rücktritt:

Bei Rücktritt bis zu 10 Tagen vor dem Seminar erheben
wir eine Bearbeitungsgebühr von 50,- € zzgl. MwSt.
Nach dieser Frist ist die Teilnahmegebühr gemäß
Rechnung zu zahlen. Die Seminarunterlagen werden
dann zugesandt.

Weitere Informationen:

FAPS-TT GmbH
Sigrun Holzinger
Telefon: 0911 / 58058-55; Telefax: 0911 / 58058-77
E-Mail: service@faps-tt.de

Ankündigung weiterer Veranstaltungen:

- 07.03.2012: Mechatronische Produktentwicklung
- 18.04.2012: Mensch-Maschine-Interaktion
- 20.06.2012: MID-Gestaltungsworkshop

Fachseminar

**Innovationen in der
Elektronikproduktion**

- Fertigungsprozesse
- Leistungselektronik
- Zukünftige Herausforderungen
- Referenten aus Industrie und Wirtschaft

30. November 2011

Nürnberg

Forum im Park
Nordostpark 89

Fachliche Leitung:

Prof. Dr.-Ing. J. Franke,
Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Ich melde mich an für das Fachseminar:
Innovationen in der Elektronikproduktion, 30.11.2011

Titel, Vorname, Name

Firma

Abteilung

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum, Unterschrift

Antwort

FAPS-TT GmbH
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg

Elektronikproduktion

Die fortschreitende Miniaturisierung elektronischer Bauelemente, die Einführung neuartiger Schaltungsträger und innovativer Verbindungstechnologien sowie die Produktion mit alternativen Materialien führen zu neuen Herausforderungen in der Elektronikproduktion. Für die Aufbau- und Verbindungstechnik gilt es, Anlagen und Prozesse anzupassen oder neu zu entwickeln. Diese weiterführende Optimierung erfordert innovative Strategien und neuartige Konzepte. Im Rahmen dieses Seminars stellen erfahrene Experten aus Industrie und Forschung neue Ansätze zur Technologieoptimierung und ihre Erfahrungen mit der praktischen Umsetzung vor. Entlang der Prozesskette der Aufbau- und Verbindungstechnik werden aktuelle Schwerpunkte gesetzt sowie neue Herausforderungen im Umfeld der Elektronikproduktion aufgezeigt.



Ziel der Veranstaltung ist es, einen aktuellen Informationstransfer mit Vorträgen, ergänzenden Fachdiskussionen sowie den Vorführungen in den Labors zu präsentieren. Das Forum in der Forschungsfabrik Nürnberg im Nordostpark mit dem Labor zur Elektronikproduktion bietet Ihnen hierfür die besten Möglichkeiten. Aufgrund des vielfältigen Tagesprogramms haben Sie die Gelegenheit zur Diskussion individueller Problemstellungen und spezifischer Sachfragen zur Aufbau- und Verbindungstechnik.

Programm

- 09:00 **Begrüßung und Moderation**
Rüdiger Busch, Clustermanager Nordbayern
Cluster Mechatronik & Automation e. V., Nürnberg
- 09:05 **Leistungsfähige Fertigungskonzepte für eine innovative Baugruppenmontage**
Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke, Lehrstuhlinhaber
Lehrstuhl FAPS, Universität Erlangen-Nürnberg
- Fertigungsprozesse**
- 09:30 **Trends und Innovationen in der Bestückungstechnologie**
Jens Deyerling, Sales Engineer
Fuji Machine MFG. (Europe) GmbH, Mainz-Kastel
- 10:00 **Bestückung elektronischer Bauteile auf dreidimensionalen MID-Strukturen**
Karl Görmiller, Geschäftsführer
MID-TRONIC Wiesauplast GmbH, Wiesau
- 10:30 *Kaffeepause*
- 11:00 **Haftungsverbesserung durch Reinigung**
Martin Königer, Prozessingenieur
ZESTRON Europe, Ingolstadt
- 11:30 **Inspektionslösungen SPI / AOI / AXI**
Holger Hansmann, Vertrieb Europa
Viscom AG, Hannover
- Leistungselektronik**
- 12:00 **Integrationsmöglichkeiten von hohen Strömen in die Leiterplatte**
Markus Wölfel, Geschäftsführer
JUMATECH GmbH, Eckental
- 12:30 *Mittagspause*

Programm

- 13:30 **Innovative Aufbau- und Verbindungstechnik für Leistungshalbleitermodule**
Dr. Karsten Guth, Leiter Packaging Technologie
Leistungsmodule, Infineon Technologies AG, Warstein
- 14:00 **Verbindungstechnik für die Leistungselektronik**
Manfred Fahrenbach, Geschäftsführer
EUTECH GmbH, Dusslingen
- 14:30 **Silbersintern als neue AVT in der Leistungselektronik**
Ulrich Sagebaum, Projectleader Technology, Assembly
SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG, Nürnberg
- 15:00 *Kaffeepause*
- Zukünftige Herausforderungen**
- 15:30 **Zuverlässigkeitsuntersuchungen hochminiaturisierter Flip-Chip Verbindungen**
Stefan Härter, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Lehrstuhl FAPS, Universität Erlangen-Nürnberg
- 16:00 **Energieeffizienz in der Elektronikproduktion am Beispiel von Lötanlagen**
Manfred Wolff, Area Sales Manager
Ersa GmbH, Wertheim
- 16:30 **Prozessübergreifende Diagnose in der Elektronikfertigung**
Dr.-Ing. Friedrich W. Nolting, geschäftsführender
Gesellschafter diplan GmbH, Erlangen
- Abschlussdiskussion und Laborführung**
- 17:00 **Abschlussdiskussion**
- 17:30 **Laborbesichtigung**
im Schwerpunktlabor zur Elektronikproduktion mit
Versuchshalle, Messraum und Prüflabors